

2206-10341/



特点:

● 频率: 0.01~6GHz

● 损耗: 2.2dB

● 衰减步进: 0.25dB

● 衰减位数:6位

● QFN 封装

● 尺寸: 4×4×1.5mm

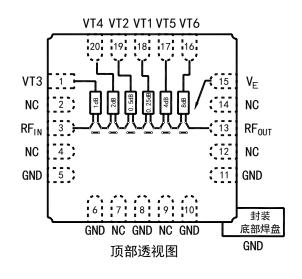




性能参数:(50Ω系统, T_A=-55~+85℃)

会器力标	符号	测试条件	参数值			*	A 234-
参数名称			MIN	TYP	MAX	单位	备注
频率范围	f		0.01		6	GHz	
插入损耗	IL			2.2	3.5	dB	
输入驻波比	VSWR _I	V _E =-5V f=0.01~6GHz 控制电平: 0/+5V		1.5:1	1.8:1		单位衰减状态
输出驻波比	VSWR ₀			1.5:1	1.8:1		单位衰减状态
衰减范围	At		0		15.75	dB	
衰减步进	Ai			0.25		dB	
衰减精度	ΔΑ		-0.6		+0.8	dB	单位衰减状态
相位波动	Δφ		-5		+5	٥	单位衰减状态
输入 1dB 压缩点	P ₋₁	V_E =-5 V , f =0.01 \sim 0.5 G Hz	10			dBm	0 态
制入 IUD 压缩点		V_E =-5V,f=0.5 \sim 6GHz	20			dBm	
控制电平	VT _H		+4.5		+5.0	V	
	VT∟		0.0		+0.5	V	
电源电压	VE		-4.75	-5.0	-5. 25	V	功能正常
电源电流	I _E				10	mA	
质量	m				2.0	g	

功能框图:



引脚定义:

引脚编号	符号	描述	
3	RF _{IN}	射频输入端,DC 耦合	
13	RF _{OUT}	射频输出端,DC 耦合	
15	VE	电源电压端	
16	VT6	8dB 衰减控制端	
17	VT5	4dB 衰减控制端	
18	VT1	0.25dB 衰减控制端	
19	VT2	0.5dB 衰减控制端	
20	VT4	2dB 衰减控制端	
1	VT3	1dB 衰减控制端	
5/6/8/10/11	GND	接地端	
底部焊盘	GND	接地端	
其他	NC	悬空	

0.01~6GHz 六位数控衰减器

02206-1934VC

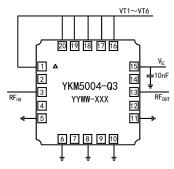
极限参数表:

参数名称	极限值
输入射频功率	+27 dBm
电源电压	-7 V
控制电压	+5.5 V
装配温度	260℃, 20s
工作温度	-55~+85℃
贮存温度	-55∼+125℃
静电防护等级(HBM)	Class 1A

超过以上条件,可能引起器件永久损坏。

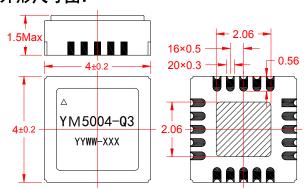


推荐外围电路:



注:产品输入输出端口无电压,若前后级联有直流输入,则需要根据使用频段增加合适的耦合电容。

外形尺寸图:



- 注: 1、单位: mm, 未注明公差按±0.15mm;
 - 2、产品采用气密陶瓷封装,引脚表面镀镍金 (Ni:1.2~8.9um, Au:1.2~5.7um);
 - 3、产品标识采用激光刻字。

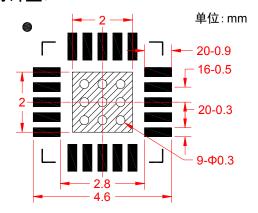
真值表: (0: 0V, 1: +5V)

衰减量	控制输入						
及 東	VT1	VT2	VT3	VT4	VT5	VT6	
零态	0	0	0	0	0	0	
0.25dB	1	0	0	0	0	0	
0.5dB	0	1	0	0	0	0	
1dB	0	0	1	0	0	0	
2dB	0	0	0	1	0	0	
4dB	0	0	0	0	1	0	
8dB	0	0	0	0	0	1	
15.75dB	1	1	1	1	1	1	

控制电流

状态	电压	电流(典型值)		
VT_L	0∼+0.5V	0∼20uA		
VT _H	+4.5~+5.0V	100∼200uA		

推荐焊盘:



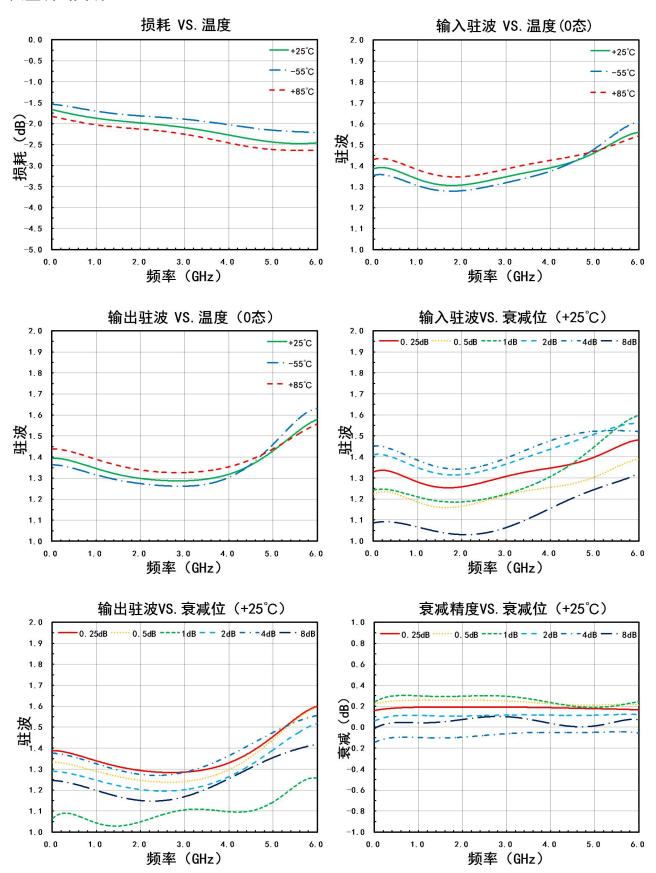
字符标志:

标识	说明	备注			
YMK5004-Q3	产品型号				
Δ	1 脚				
YYWW	批次号				
XXX	序列号				



USITE/八匹致江及城市

典型测试曲线:





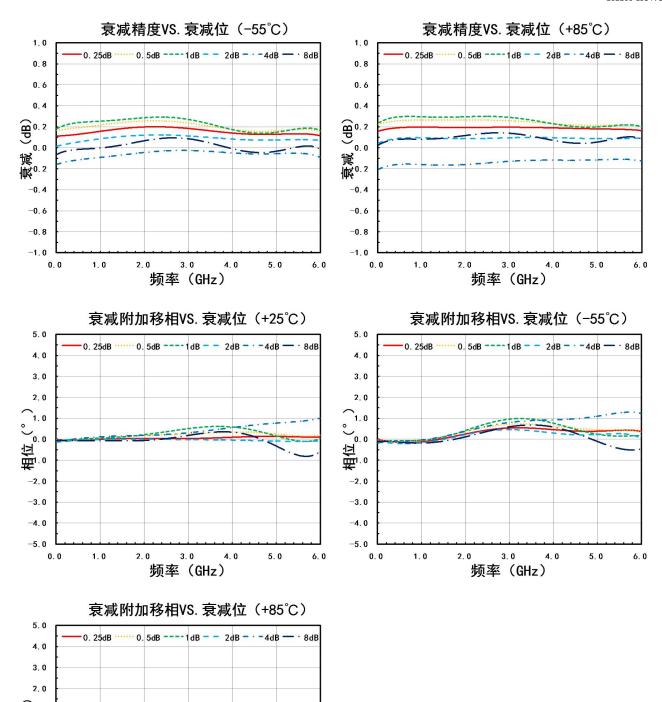


1.0 0.0 1.0 -2.0 -3.0 -4.0 -5.0 0.0

1.0

0.01~6GHz 六位数控衰减器

202206-1934V



5.0

3.0

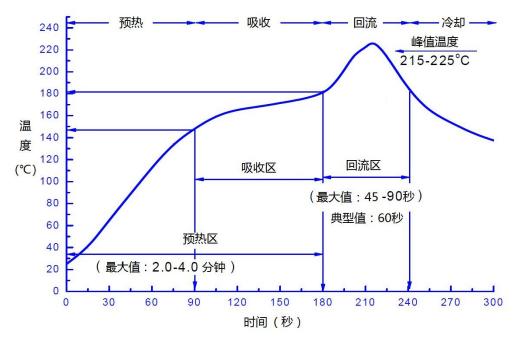
频率 (GHz)

0.01~6GHz 六位数控衰减器

02206-1934VC

产品使用注意事项:

- 1.产品属于静电敏感器件,产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护;
- 2.产品使用时请保证接地良好(GND引脚和底部金属化区域);
- 3.产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用,采用 Sn63/Pb37 锡膏,熔点 183℃回流焊接,回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线,因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线, 实测回流基板温度不得超过 230℃。

- 4.如特殊情况需采用手工焊接,烙铁温度350℃,焊接时间不超过3秒;回流及手工焊接次数不大于3次。
- 5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装,存放条件:温度 10~35℃,湿度 35~65%RH;对于需长期储存(超过半年)产品尽量在充氮干燥环境下存放。
- 6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境,客户在对产品焊接及清洗完成后,应对产品进行三防喷涂处理,以提高产品耐环境适应性能力。